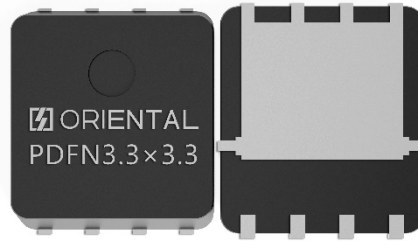


PDFN3.3x3.3 封装型式

1、封装类型：

PDFN (Power DFN) 是功率型双边扁平无引脚封装，尺寸为 3.3mm×3.3mm，具有较小的体积和较高的功率密度，适合高功率密度应用。

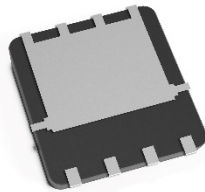


2、结构特点：

超高空间利用率：其面积仅为 3.3mm x 3.3mm，比传统的 TO-220 或 SOP-8 封装小得多，非常适用于高密度 PCB 设计，如智能手机、平板电脑、超薄笔记本和便携式设备。

优异的散热性能：得益于底部的大散热焊盘，热量可以快速导出

适合高频应用：无引线设计和低寄生参数使其在高频开关电源（如 DC-DC 转换器）中表现良好。



3、典型应用：

AI 服务器和数据中心电源系统

高功率 DC-DC 转换器

汽车电子、不间断电源 (UPS)
BLDC 电机驱动、电源管理电路等



4、电气性能优势：

低导通电阻 ($R_{ds(on)}$)，降低功率损耗。

快速开关特性，支持高频应用。

良好的散热性能，支持高结温 (如 175°C)。